

債務保証先企業名及び保証プロジェクト

企業名	株式会社 アフィット
代表者 住所 電話番号 資本金・従業員数 http E-mail	海江田 省三 東京都日野市神明三丁目6番地の14 042-581-5481 76.7百万円・20人 http://www.afit.co.jp sato@afit.co.jp
保証金額	24百万円
プロジェクト名	金属粒子描画電子写真技術(ZEOMET技術)
プロジェクト概要	<p>半導体ICチップの製造プロセスで、ウェハ上の微小チップ面に無数の半田ボールを電極に搭載する必要がある。チップの微小化・多機能化に伴い従来のマスクを利用した搭載法は電極の高密度化や生産効率の観点から限界であった。</p> <p>本プロジェクトは、マスクを使用せず、PCより指示することで直接ウェハ上のチップに半田ボールを搭載できる。マスクを使用せず、電子写真技術で半田ボールを現像機・感光体・ウェハと移動させるもの。</p> <p>マスクを利用しないこと等による原価低減効果が大きく、次世代半導体製造の合理化に寄与する画期的なもの。将来的には、この技術を利用して基板の直接配線描画等にも応用可能である。</p>

企業名	株式会社 ルス・コム
代表者 住所 電話番号 資本金・従業員数 http E-mail	小島 袈裟雄 横浜市青葉区つつじが丘27-15 042-637-2029 105百万円・9人 http://www.luzcom.jp k-kojima@luzcom.jp
保証金額	16百万円
プロジェクト名	半導体検査用コンタクトプローブ分野の次世代プローブ向けMEMSスプリングの開発
プロジェクト概要	<p>ICチップ電極の電通は半導体検査装置のプローブカードによってウェハ上の各チップの電極毎に検査されている。ICチップの高密度化に伴い、次世代型プローブカードの電子部品には更なる微細化が求められている。当社は、独自の電鑄技術で、プローブカードの重要な部品であるプローブバレル(プランジャー針の収納微細管)の微細化を実現、微細化に貢献している。</p> <p>現在、バレルに収納され電通検査をする針を収縮させるコイルスプリングもその微細化とバネ圧が限界で、更なる高密度電極の検査方法は困難である。本件はこれに代替する他社の追随のない世界一微細なスプリング製造プロジェクトの実現を狙うもの。当社の得意な電鑄技術を基本に、フォトレジスト技術やレーザー技術を利用して実現をはかるものである。</p>

債務保証先企業名及び保証プロジェクト

企業名	長浜バイオラボラトリー 株式会社
代表者 住所 電話番号 資本金・従業員数 http E-mail	大石 孝昭 本社:滋賀県長浜市田村町1388 0749-53-0037 30百万円、6人 http://www.nbl.bz/ info@nbl.bz
保証金額	8百万円
プロジェクト名	第2世代DNAインクおよびDNA情報瞬間検出法
プロジェクト概要	<p>本プロジェクトは、印刷物のインクにDNAを含ませ真贋判定を行なうもの。従来のDNAインク鑑定は、印刷物の破損をとまなうことと鑑定時間がかかるため、現場で行なうことができないという問題があった。</p> <p>当社は独自の技術により、破損せずに短時間で鑑定を可能とした。このため現場での鑑定でも可能となった。</p> <p>本技術は、真贋判定に役立ち、社会的貢献度が高いと思われる。</p>